Powered by PHOTONICS SYSTEMS GROUP

High Speed Laser-Nutzentrenner

ELEKTRONIK

DIVIDOS

INNOLAS SOLUTIONS

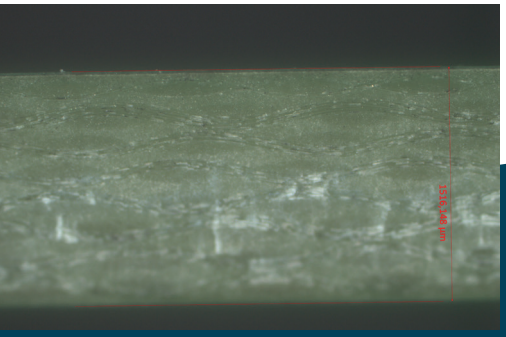
DIVIDOS

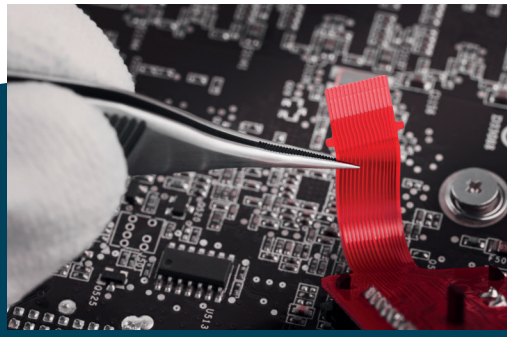
Leistungsvorteile

- Durch FULL CUT-Verfahren (trennen ohne Stege) höhere Nutzendichte pro Leiterplatte
- Schneiden jeglicher, auch komplexer Formen (z. B. Kreisformen)
- Dedizierte Lösung für das Trennen von Leiterplatten
- Hohe Kantenqualität und keine Rückstände
- Keine Verbrennung (Karbonisation)
- Industrie 4.0-fähig
- Automatische Kamerakalibrierung
- Automatisiertes Bildverarbeitungssystem für präzise Ausrichtung und Skalierung, Offset-, Trapez- und Rotationskompensation

Optionen

- Zweiter Prozesskopf (Scanner)
- InnoLas Postprocessor für CAD-Datenübertragung, -bearbeitung und Laserrezepterstellung
- Absaugsystem
- MES-Schnittstelle
- Automatische Fokuseinstellung
- Integrierte Prozessmesstechnik





Technische Daten

Optik	High Speed Scanner
Achsen	X-Y / Z
Genauigkeit	< ± 25 µm
Wiederholgenauigkeit	< ± 5 µm
Substratgröße	457 x 457 mm
Material	Starre und flexible Leiterplatten
Bilderkennungssystem	InnoLas µVision
Software	Windows 10; IoT

Automatisierung

- Voll- und halbautomatische InnoLas Automation
- Kundenspezifische Automatisierungslösungen
- Stand Alone System und Inline-Integration
- SMEMA-kompatibel mit 3rd-Party-Automatisierung

Laserprozesse

- Laser-Nutzentrennen
- Laserablation

Änderungen der Spezifikation vorbehalten.
InnoLas Solutions GmbH, 03/2019

InnoLas Solutions GmbH
Pionierstraße 7
82152 Krailling

T +49 (89) 8105 9168-1000
www.innolas-solutions.com
info@innolas-solutions.com